



kingston.com/emcp

eMCP

Doskonałe, energooszczędne zintegrowane rozwiązanie pamięci masowej do ograniczonych przestrzennie do zastosowań mobilnych, IoT i wbudowanych

Firma Kingston oferuje szereg komponentów eMCP zgodnych ze standardem JEDEC. Rozwiązanie eMCP łączy wbudowaną pamięć masową eMMC (MultiMedia Card) oraz pamięć DRAM LPDDR (Low-Power Double Data Rate) w niewielkich rozmiarów pakiecie MCP (Multi-Chip Package). Rozwiązanie to zapewnia lepszą integrację, pozwalając na zmniejszenie ogólnych rozmiarów konstrukcji. eMCP to idealne połączenie pamięci i pamięci masowej do ograniczonych przestrzennie systemów, takich jak smartfony, tablety, urządzenia nasobne i różne urządzenia Internetu rzeczy (IoT).

GŁÓWNE ZALETY

- Zarządzane rozwiązanie pamięci flash NAND, które upraszcza projektowanie i utrzymanie produktu dzięki standardowemu interfejsowi eMMC. Pomaga to znacznie ograniczyć złożoność konstrukcji i skrócić proces kwalifikacji.
- Wysoce zintegrowane połączenie pamięci i pamięci masowej zmniejsza ilość miejsca zajmowanego obudowie systemu, dzięki czemu eMCP jest idealnym rozwiązaniem do urządzeń o niewielkich rozmiarach.
- Pamięć DRAM o niskim poborze mocy zmniejsza całkowite zużycie energii, dzięki czemu eMCP jest optymalnym rozwiązaniem do wielu zastosowań z zasilaniem bateryjnym, takich jak urządzenia nasobne i przenośne produkty IoT.
- Mniejsza złożoność zestawienia materiałowego dzięki ograniczeniu liczby komponentów.
- Dostępne są różne konfiguracje oprogramowania sprzętowego, umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań pod względem wydajności, zużycia energii i żywotności.

SEGMENTY RYNKU



Smartfony i Tablety



Urządzenia nasobne



Akceleratory AI



Internet rzeczy

NUMERY KATALOGOWE I DANE TECHNICZNE PAMIĘCI eMCP

Pamięć eMCP oparta na technologii LPDDR3

Numer katalogowy	Pojemność		Standard		Wymiary	FBGA	Temperatura pracy
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C do 85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C do 85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C do 85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C do 85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C do 85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C do 85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C do 85°C

Pamięć eMCP oparta na technologii LPDDR4x

Numer katalogowy	Pojemność		Standard		Wymiary	FBGA	Temperatura pracy
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C do 85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C do 85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C do 85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C do 85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C do 85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C do 85°C